

TAZMO

タツモ株式会社 決算説明資料

2025年12月期

2026年2月13日

証券コード 6266

会社案内ダウンロード



<https://tazmo.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/11/company%20guide.pdf>

INDEX

目次



01

2025年12月期 決算報告

02

2025年12月期 セグメント別業績

03

2026年12月期 業績予想

04

補足資料



01

2025年12月期 決算報告

プロセス機器事業における半導体装置と表面処理用機器事業における
売上高・利益が堅調に推移。

売上高

35,428百万円

前期比 △1.2%

営業利益

4,768百万円

前期比 △19.4%

経常利益

5,009百万円

前期比 △16.5%

親会社株主に帰属 する当期純利益

3,541百万円

前期比 △16.6%

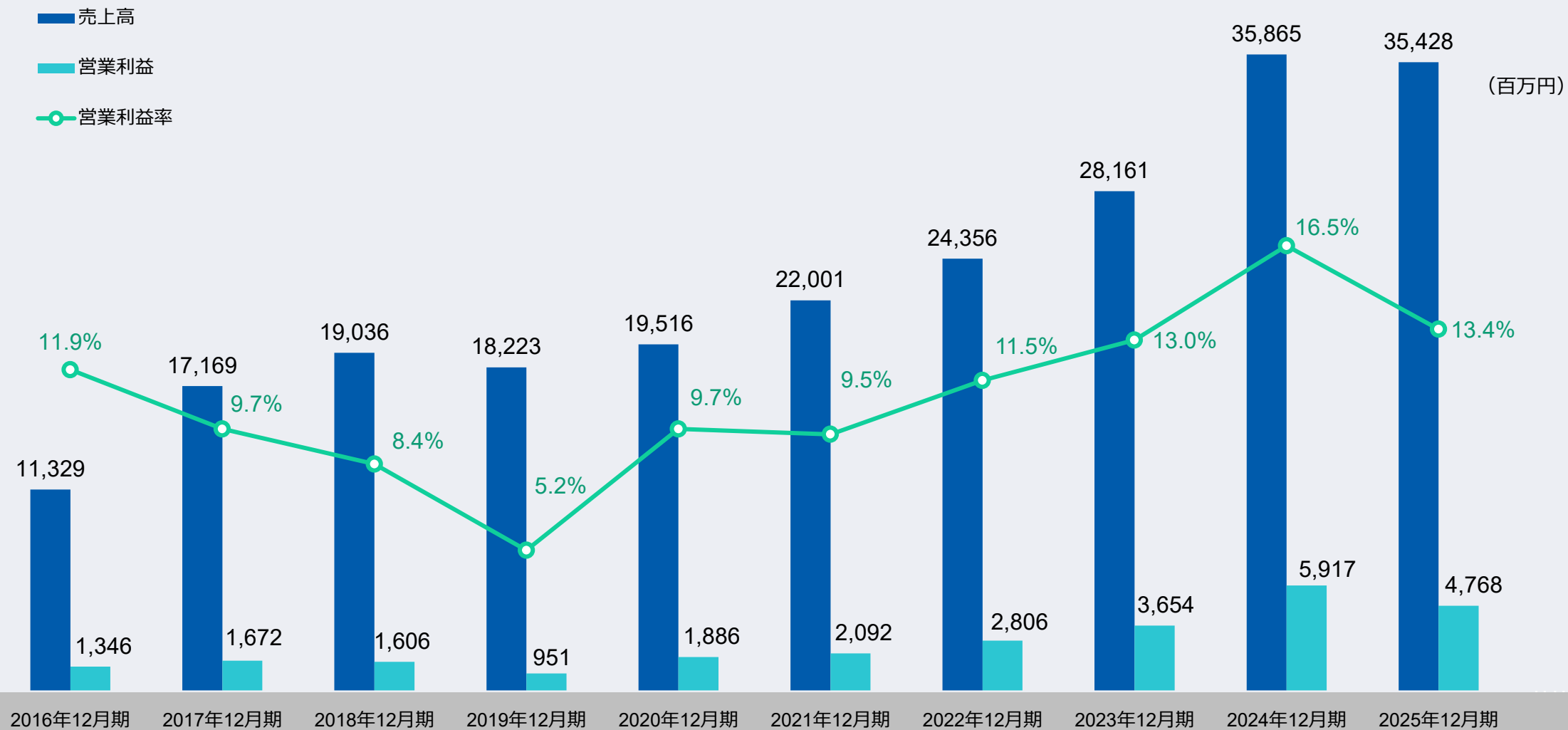
■ 概況

- プロセス機器事業の半導体装置は、先端パッケージ向け装置が順調に検収となり売上をけん引。
- 搬送機器は装置メーカーの需要や、中国市場での展開が伸び悩んだことから減収。
- 洗浄装置はウェーハメーカーの設備投資が低迷しており大幅な減収。
- 表面処理用機器事業は計画通りに検収が進み、市場の鈍化による影響はあったが増益を達成。

売上は、洗浄装置、搬送機器、PLP(※)向け案件の受注が伸び悩んだことで減収。
利益は、プロセス機器事業の半導体装置において、先端パッケージ向け装置の割合が増加したことで減益。

(百万円)	2024年12月期 実績	2025年12月期		前期比 増減率(%)	2025年12月期 修正計画	修正計画比 (%)	2025年12月期 当初計画	当初計画比 (%)
		実績	売上比(%)					
売上高	35,865	35,428	—	△1.2	36,000	98.4	41,000	86.4
売上総利益	11,855	10,758	30.4	△9.2	—	—	—	—
営業利益	5,917	4,768	13.5	△19.4	変更なし	—	5,000	95.4
経常利益	5,998	5,009	14.1	△16.5	変更なし	—	5,100	98.2
親会社株主に帰属 する当期純利益	4,247	3,541	10.0	△16.6	変更なし	—	3,500	101.2
自己資本利益率 (ROE)	19.3%	14.0%	—	△5.3P	—	—	—	—

※PLP：パネルレベルパッケージ



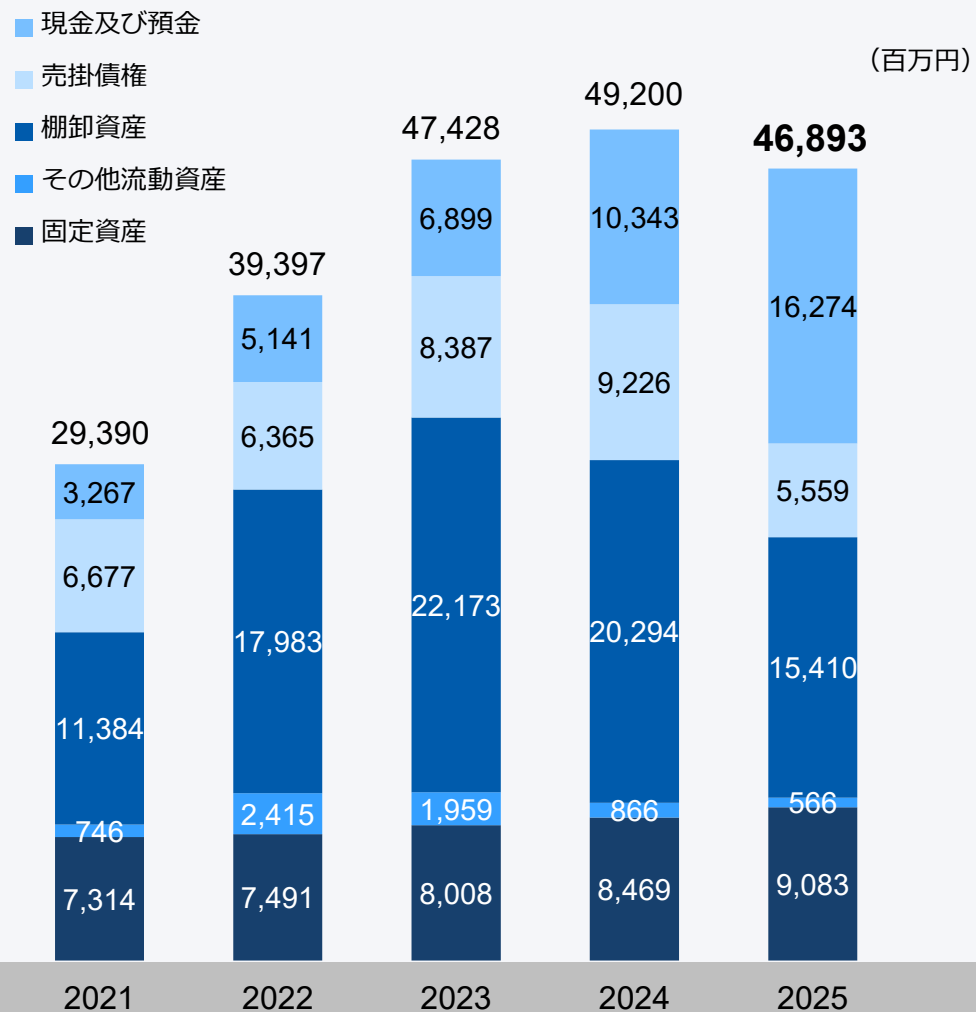
現金及び預金の増加、仕掛品の減少などにより、財務状況が改善

(百万円)	2024年12月期	2025年12月期	前期末増減
流動資産	40,731	37,809	△2,921
固定資産	8,469	9,083	613
有形固定資産	7,385	7,812	427
無形固定資産	156	199	43
投資その他資産	927	1,070	143
総資産合計	49,200	46,893	△2,307
流動負債	17,696	14,393	△3,303
固定負債	6,861	5,462	△1,398
負債合計	24,557	19,855	△4,702
純資産合計	24,642	27,037	2,394
自己資本比率	49.1%	56.6%	7.5P

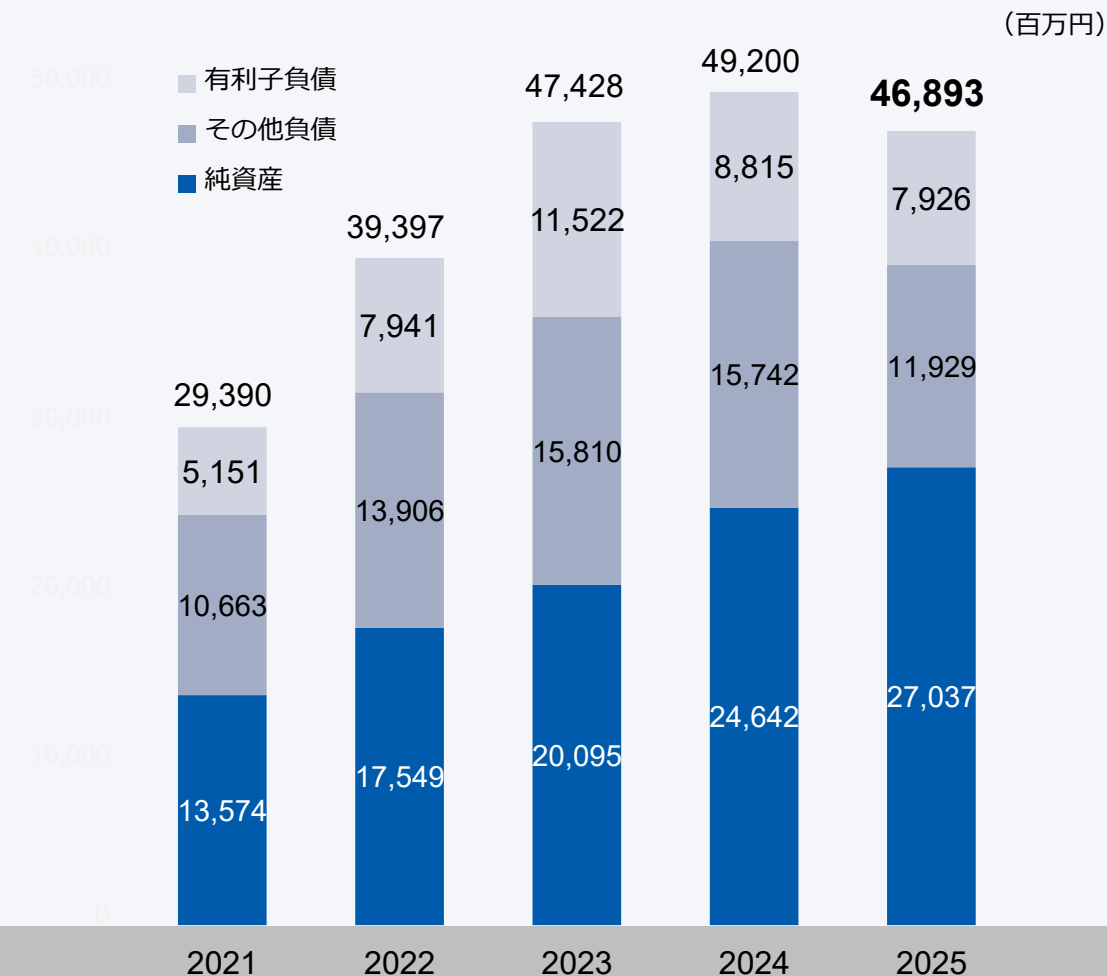
主な増減要因（前期比）

流動資産	(百万円)
現金及び預金	+5,931
受取手形及び売掛金	△2,663
電子記録債権	△1,003
仕掛品	△4,213
原材料	△675
流動負債	
電子記録債務	△1,894
短期借入金	452
契約負債	△1,592
固定負債	
長期借入金	△1,355

資産



負債／純資産



棚卸資産が大幅に減少したことなどにより、営業活動によるキャッシュ・フローが改善

(百万円)	2024年12月期	2025年12月期	前年同期比 増減
営業活動による キャッシュ・フロー	7,506	9,347	1,840
投資活動による キャッシュ・フロー	△1,710	△ 3,181	1,470
フリー・キャッシュ・ フロー	5,796	6,166	370
財務活動による キャッシュ・フロー	△3,163	△ 1,961	1,202
現金及び現金同等物の 期末残高	9,733	13,946	4,213

主な内訳

営業CF	(百万円)
税金等調整前当期純利益	5,008
棚卸資産の増減額（増加：△）	4,863
売上債権の増減額（増加：△）	3,821
仕入債務の増減額（減少：△）	△2,296
法人税等の支払額	△1,912
投資CF	
定期預金の純増減額（増加：△）	△1,702
有形固定資産の取得による支出	△1,421
財務CF	
長期借入金の借入による収入	2,000
長期借入金の返済による支出	△3,113

A blue square graphic with rounded corners, featuring a white globe with latitude and longitude lines. The number '02' is prominently displayed in white over the globe.

02

2025年12月期 セグメント別業績

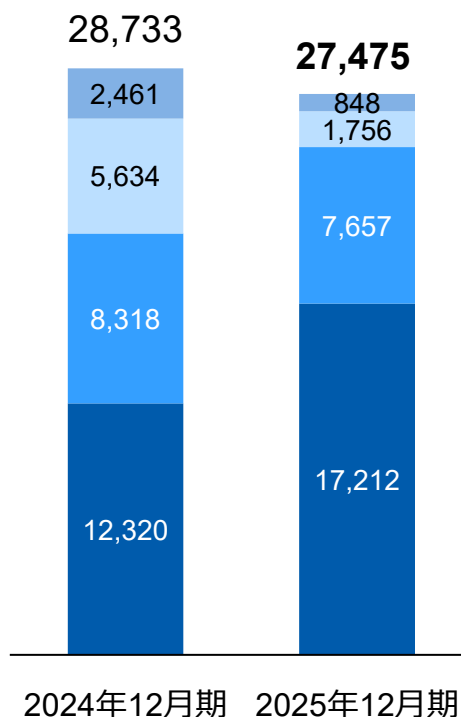
→ 2025年12月期 セグメント別業績ハイライト

(百万円)		2024年12月期 実績	2025年12月期 実績	前期比 増減率(%)	2025年12月期 修正計画	修正計画比 進捗率 (%)	2025年12月期 当初計画	当初計画比 進捗率(%)
プロセス機器事業	売上高	28,733	27,475	△4.4			33,000	83.3
	営業利益	5,484	4,089	△25.4			4,500	90.9
	■ 半導体装置	12,320	17,212	39.7			18,200	94.6
	■ 搬送機器	8,318	7,657	△7.9			9,300	82.3
	■ 洗浄機	5,634	1,756	△68.8			3,700	47.5
金型・樹脂成形事業	■ コーター	2,461	848	△65.5			1,800	47.1
	売上高	779	1,198	53.8			1,100	108.9
	営業利益	△128	56	—			50	112.0
表面処理用機器事業	売上高	6,352	6,754	6.3			6,900	97.9
	営業利益	578	602	4.1			450	133.8
セグメント間連結消去		営業利益	△17	19	—		—	—
合計	売上高	35,865	35,428	△1.2	36,000	98.4	41,000	86.4
	営業利益	5,917	4,768	△19.4	変更なし	—	5,000	95.4

売上高

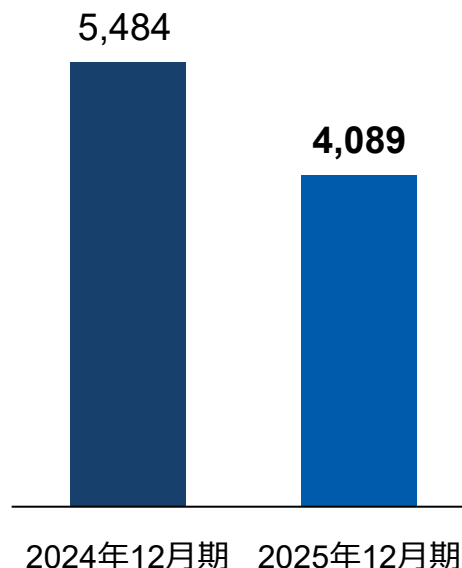
- コーター
- 洗浄機
- 搬送機器
- 半導体装置

(百万円)



営業利益

(百万円)



概況

- 半導体装置：先端パッケージ向け装置を中心に検収となり、全体の売上・利益をけん引。
- 搬送機器：装置メーカーの需要減少で減収
- 洗浄機：ウェーハメーカーの投資低迷を受け減収
- コーター：PLP（※）向け装置に注力し、2026年度からは半導体装置に統合。

市場の状況

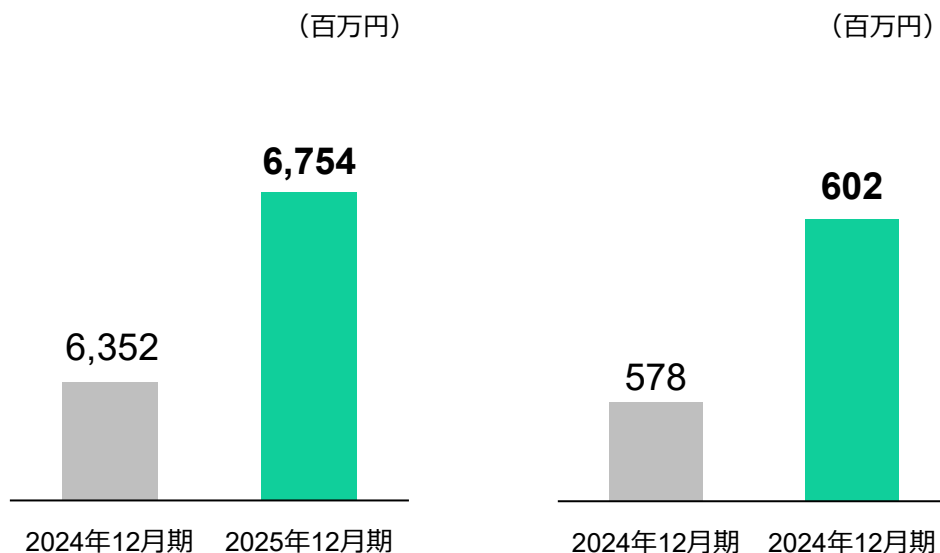
- ✓ AI関連の先端パッケージ向け装置の需要は比較的堅調であり、半導体市場全体をけん引している
- ✓ パワー半導体向け装置は前期比で売上は減少しているが、中長期的に見て電力需要の増加に伴う設備投資が見込まれる
- ✓ 先端パッケージはパネル（PLP）の開発が進んでおり、試作・量産向け装置の投資増加が見込まれる
- ✓ AI関連を除いた半導体市場の全体的な投資は低調が続いている

※PLP：パネルレベルパッケージ

表面処理用機器事業

■ 売上高

■ 営業利益



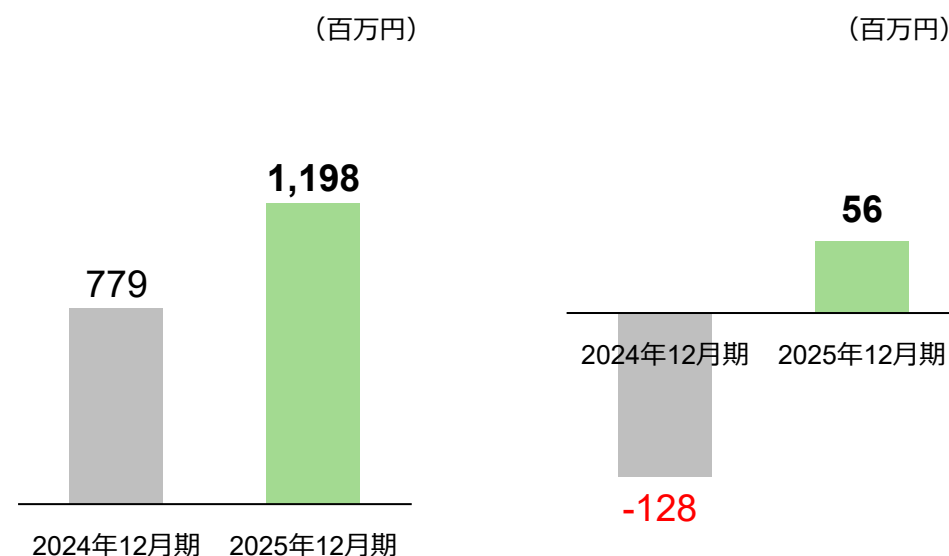
見積もり精度向上とユニット化への対応による工数削減を進め、前年比で増収増益を達成。

納入や検収時期が遅延していた大口案件も検収が進み、売上が拡大し利益にも貢献

金型・樹脂成型事業

■ 売上高

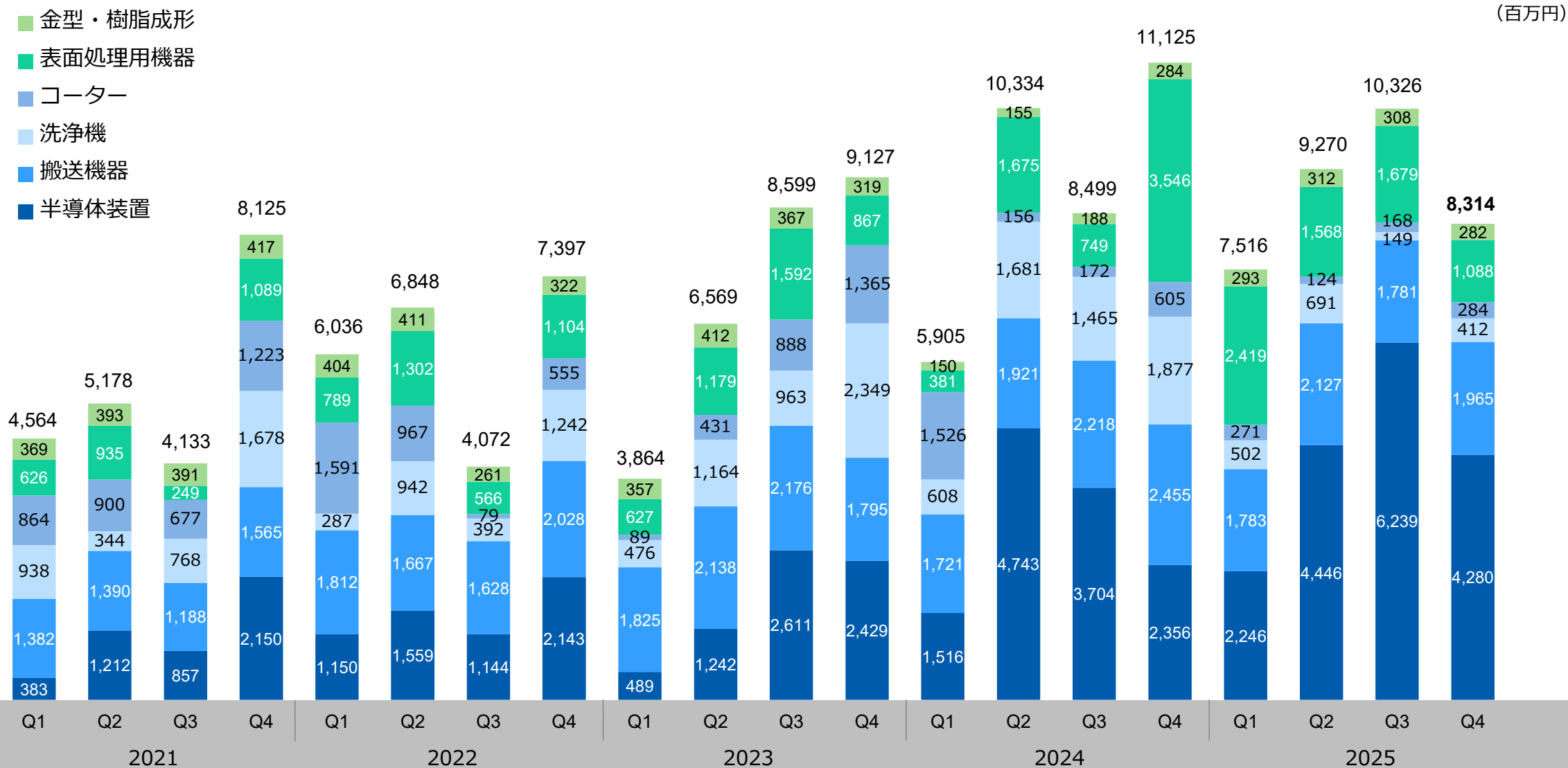
■ 営業利益



前年比での受注状況の回復や、コスト構造の改革を進めたことから、売上・利益ともに改善。

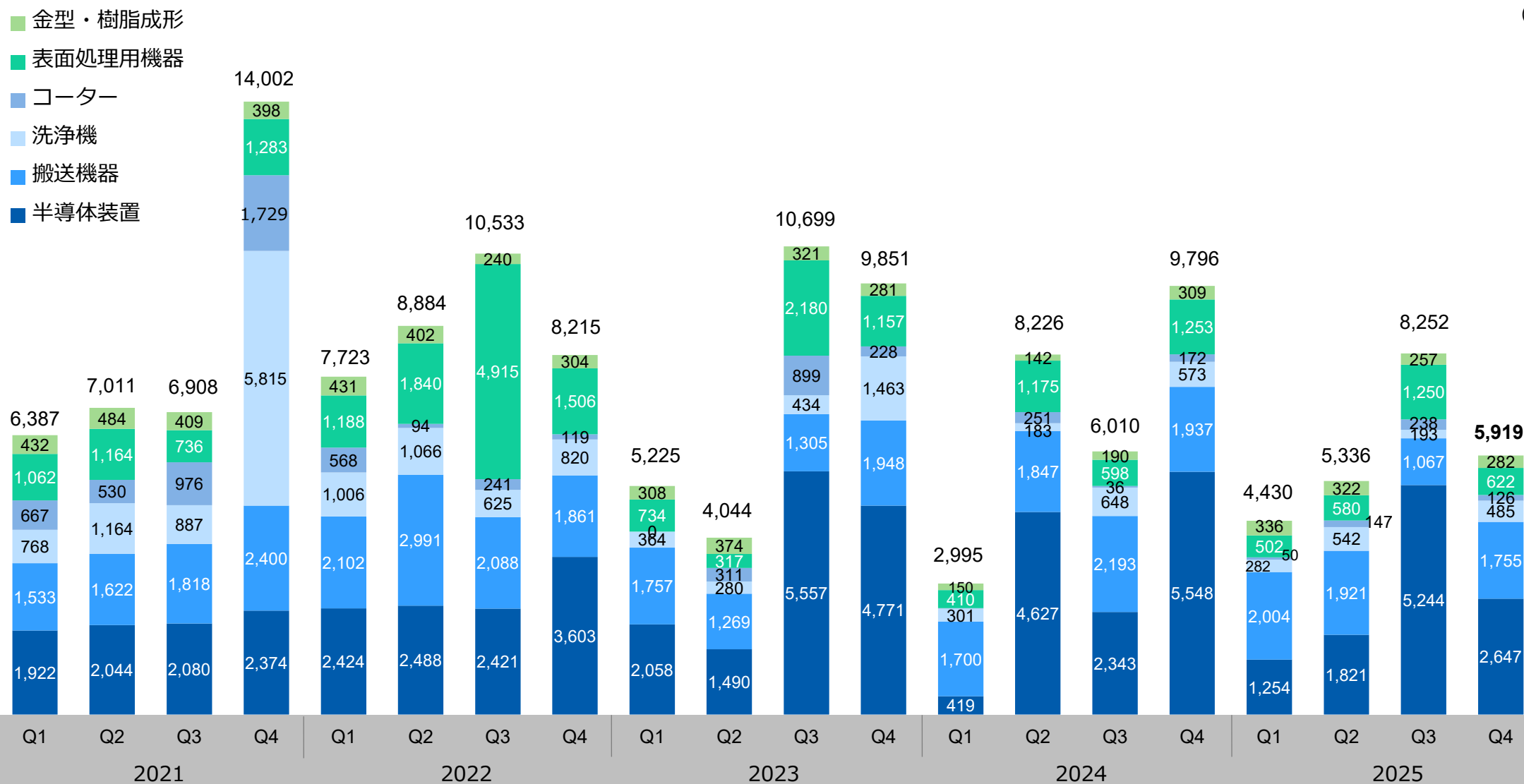
中国市場の低迷も続くことから、本事業内容の絞り込みと固定費削減（人員の他事業への異動含む）を行い、事業構造の転換を実施

セグメント別 売上高推移（四半期）

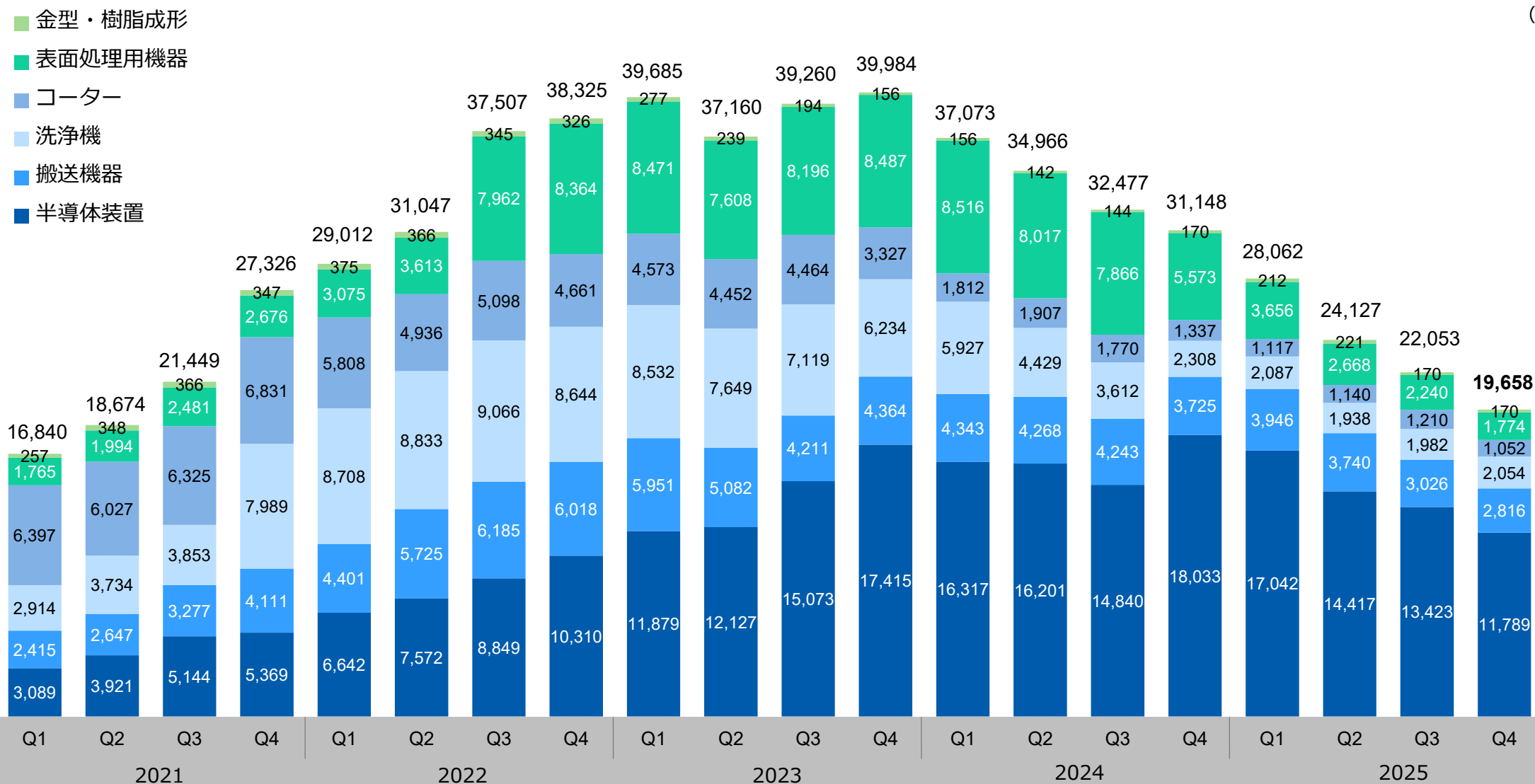


セグメント別 受注高推移（四半期）

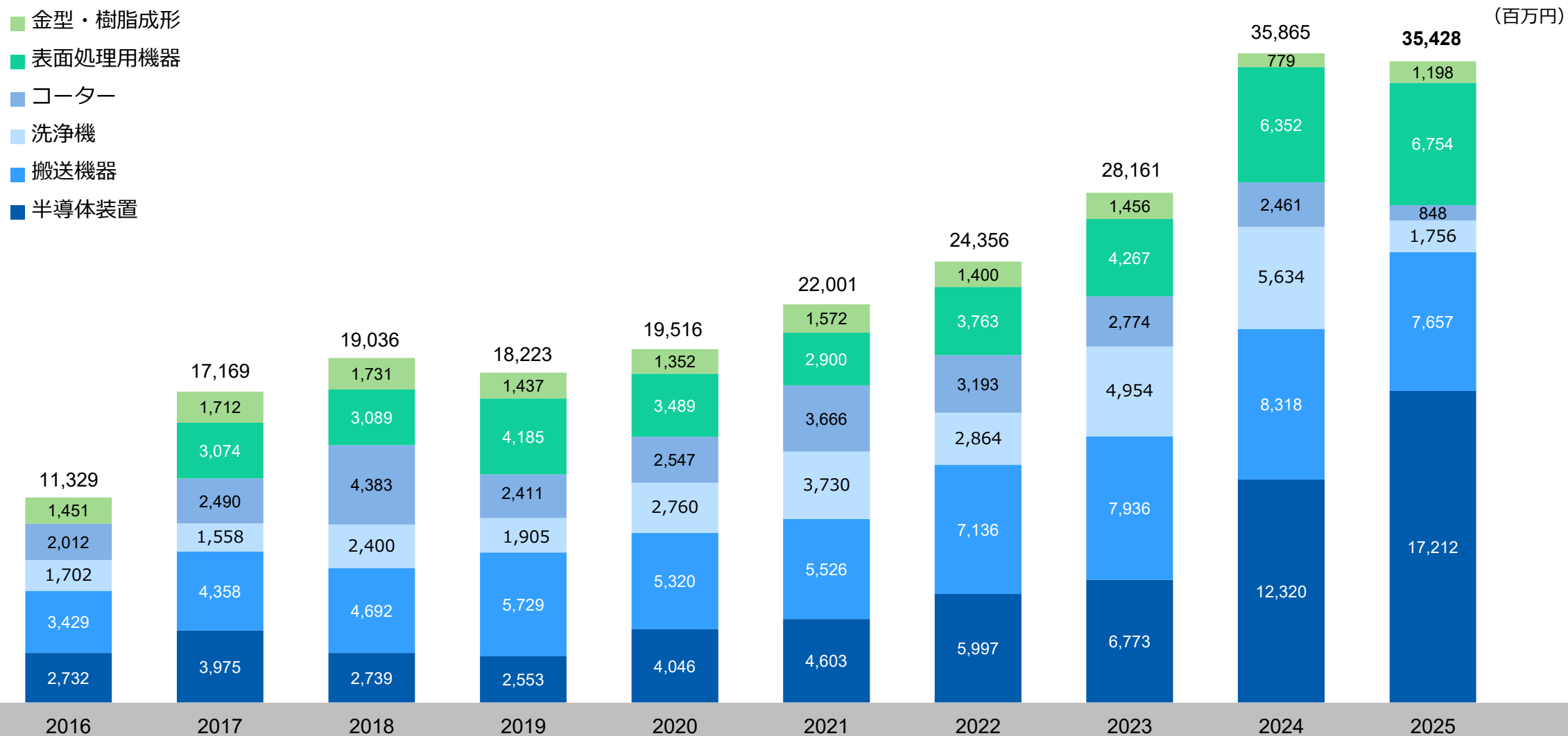
(百万円)



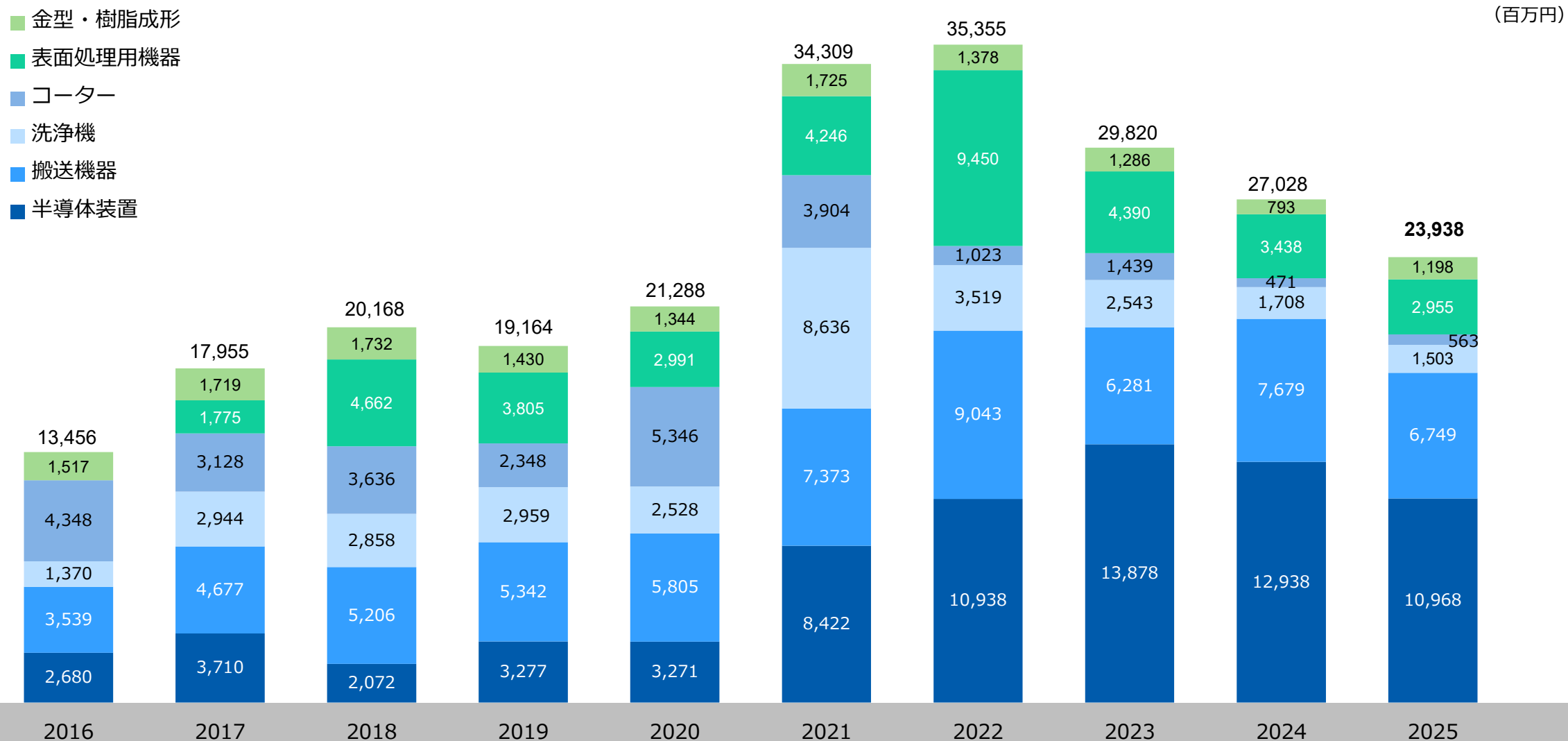
セグメント別 受注残高推移



セグメント別 売上高推移（通期）



セグメント別 受注高推移（通期）





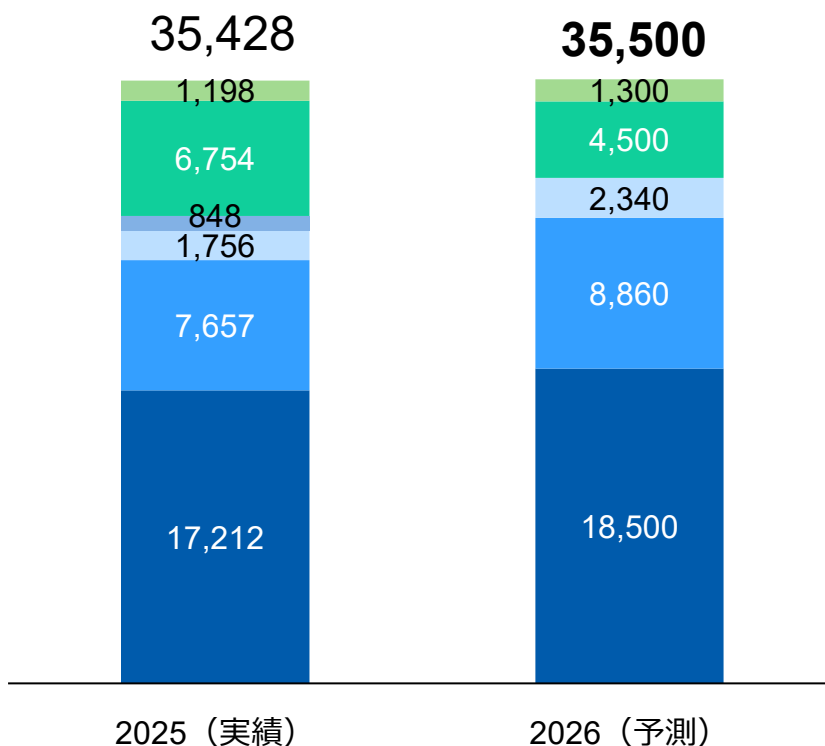
03

2026年12月期 業績予想

	第2四半期累計	通期	通期 前期比 増減率 (%)
(百万円)			
売上高	15,570	35,500	0.2
プロセス機器事業	12,870	29,700	8.1
金型・樹脂成形事業	600	1,300	8.5
表面処理機器事業	2,100	4,500	△33.4
営業利益	890	3,600	△24.5
プロセス機器事業	900	3,400	△16.9
金型・樹脂成形事業	30	70	23.9
表面処理機器事業	△40	130	△78.4
経常利益	800	3,500	△30.1
親会社株主に帰属する当期純利益	600	2,500	△29.4

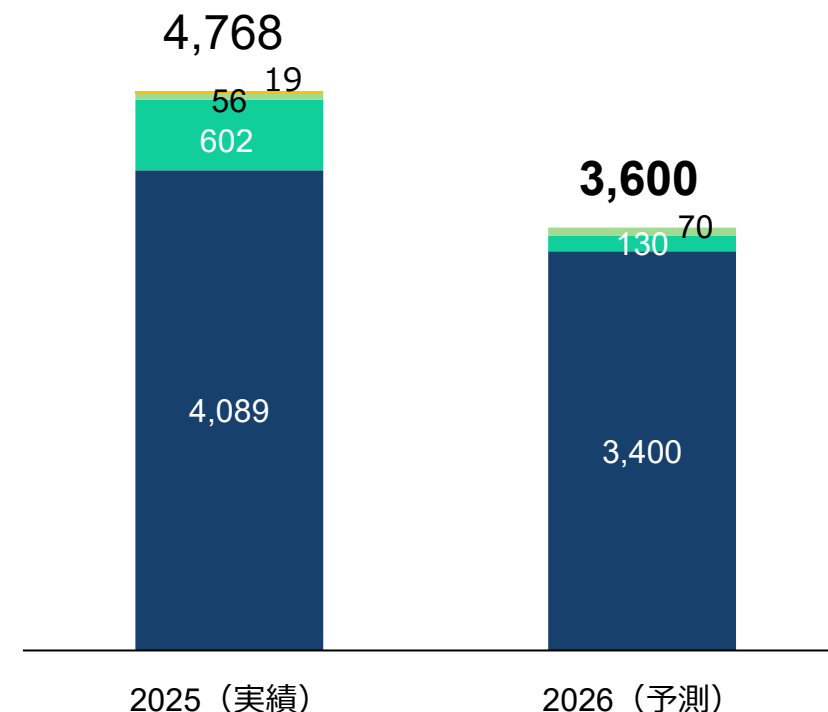
売上高

- 金型・樹脂成形
 - 表面処理用機器
 - コーター
 - 洗浄機
 - 搬送機器
 - 半導体装置
- (百万円)



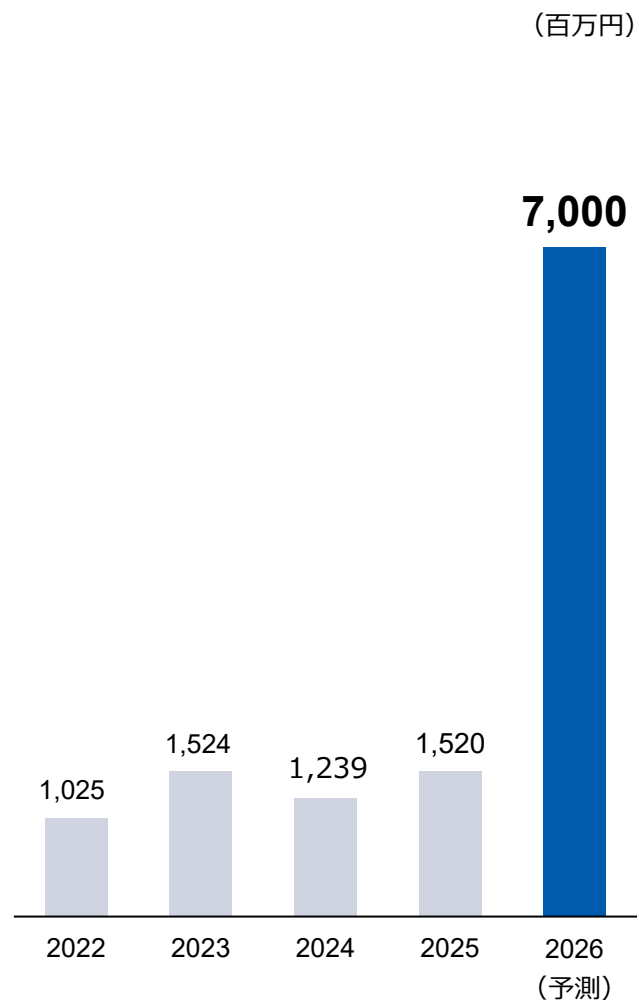
営業利益

- セグメント間調整額
 - 金型・樹脂成形
 - 表面処理用機器
 - プロセス機器
- (百万円)

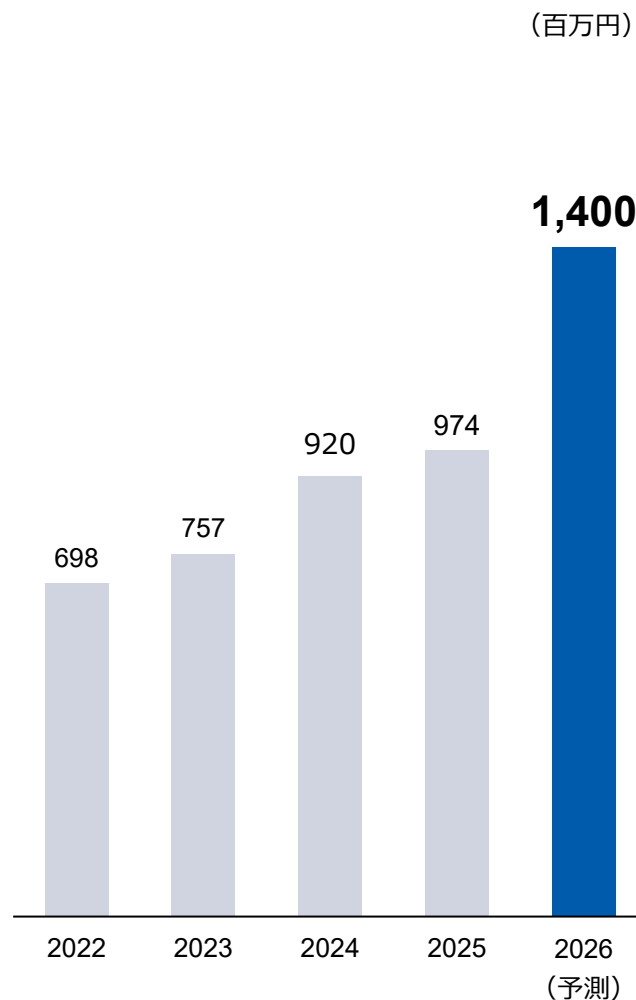


※2026年12月期より、コーターは半導体装置に含めて表示しております。

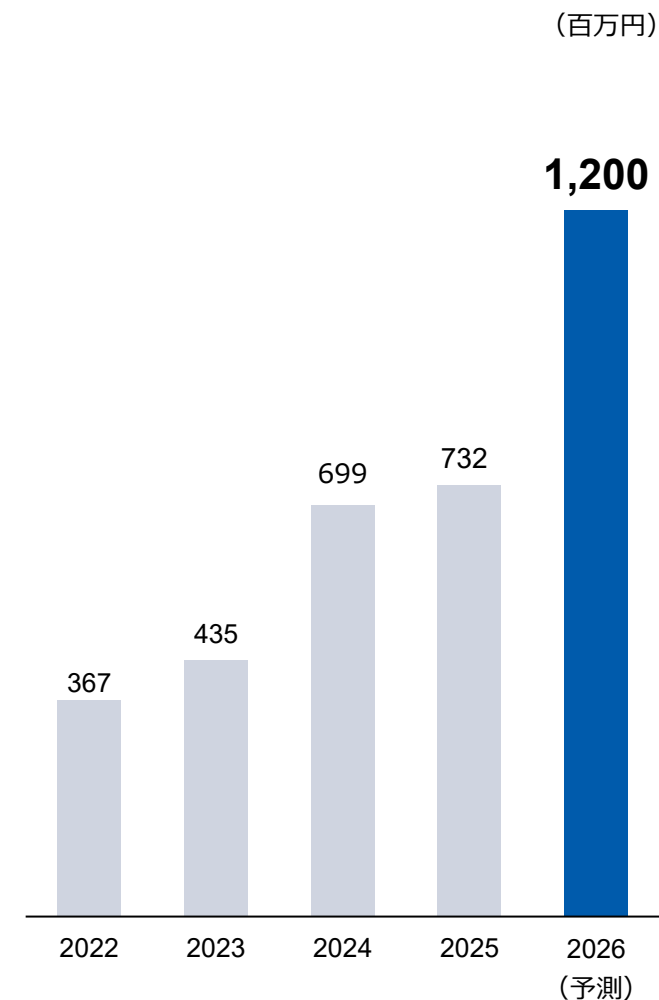
■ 設備投資額



■ 減価償却費



■ 研究開発費



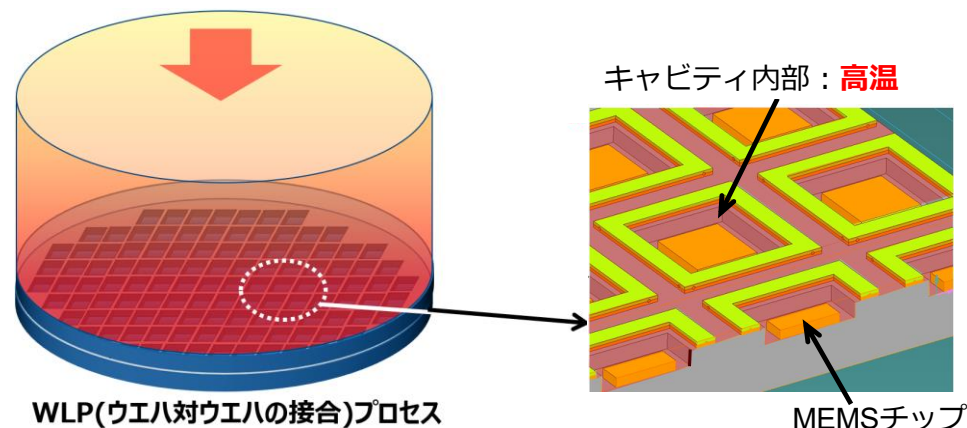
岡山県井原市、台湾への設備投資、デモ装置などを通じ、
さらなる生産能力の拡大と効率的なものづくりの実現を目指す

(億円)		(億円)	
運用		調達	
● 設備投資資金	70	● 純利益	23
● 配当金	5	● 減価償却費	14
● 長期借入金返済	30	● 長期借入金	23
● 運転資金純増減額	14		
● 現預金純増減額	△59		
	60		60

2025年はMEMSデバイスの封止技術に加えて、**異種材接合**や **SiC-SiC接合**、**テンポラリーボンディング**などの派生技術へと適用領域の拡大を検証。さらに、**各ユーザーの実デバイスに対する適合性評価**を実施することで、新規アプリケーション開拓と案件創出につながる技術基盤を強化。

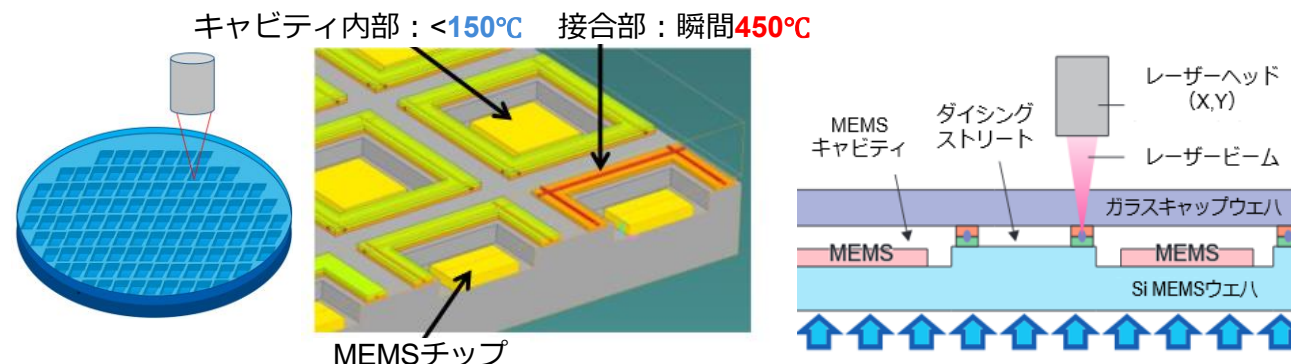
＜既存プロセス＞

ウェーハ全体を加熱・加圧し接合



＜対策プロセス (LAB) ＞

レーザーによる局所的な加熱でMEMSセンサ部を**低温**で維持しつつMEMSセンサの**ハーメチックシール**の実現を狙う



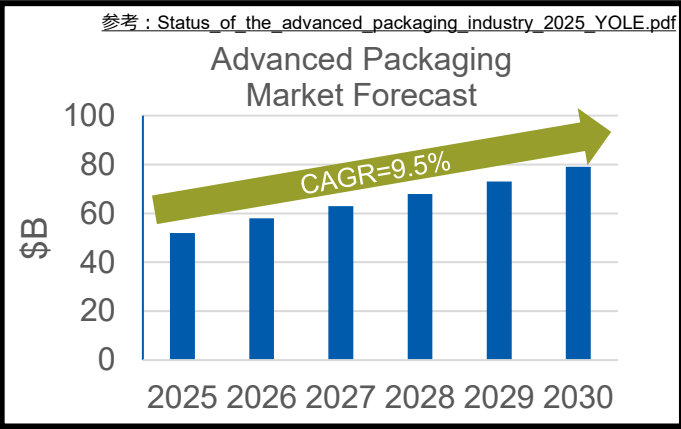
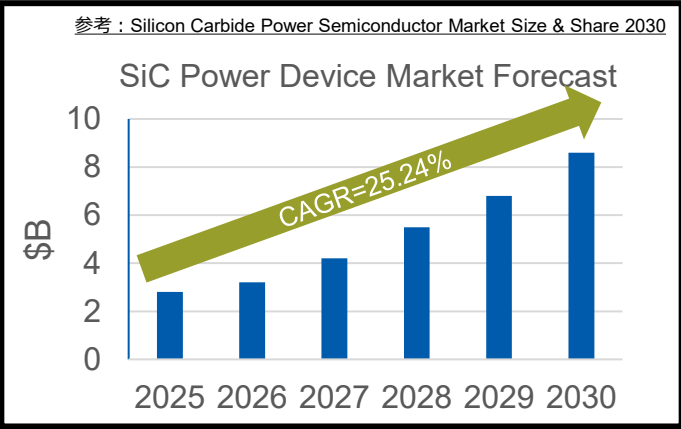
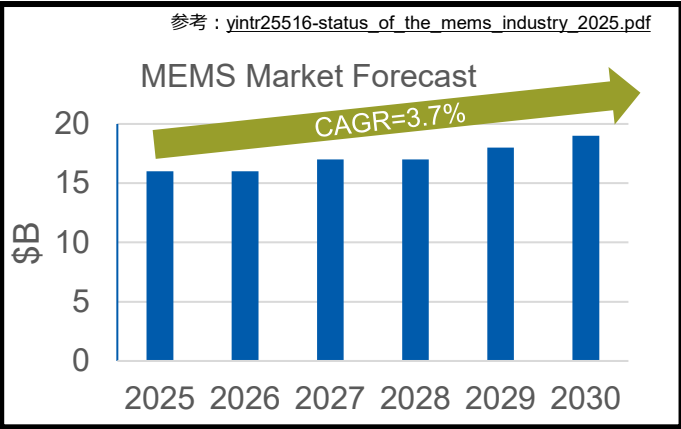
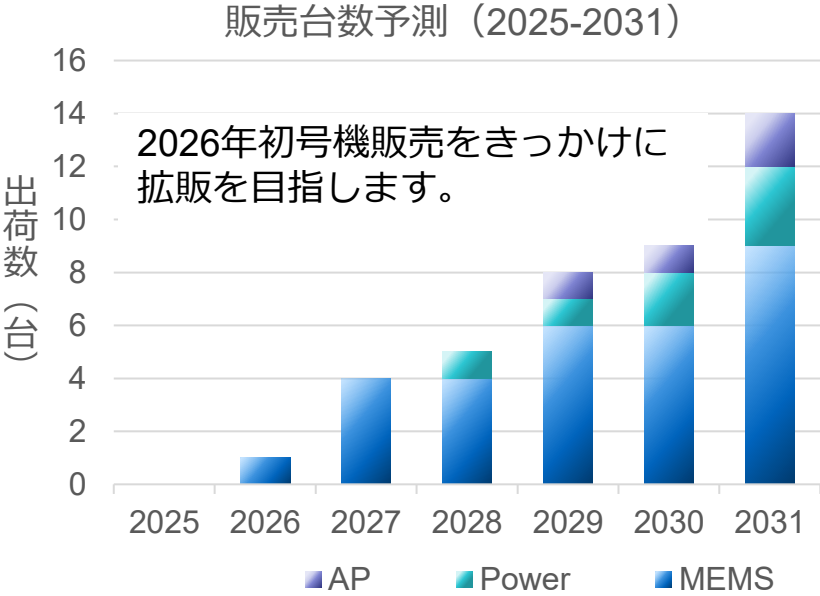
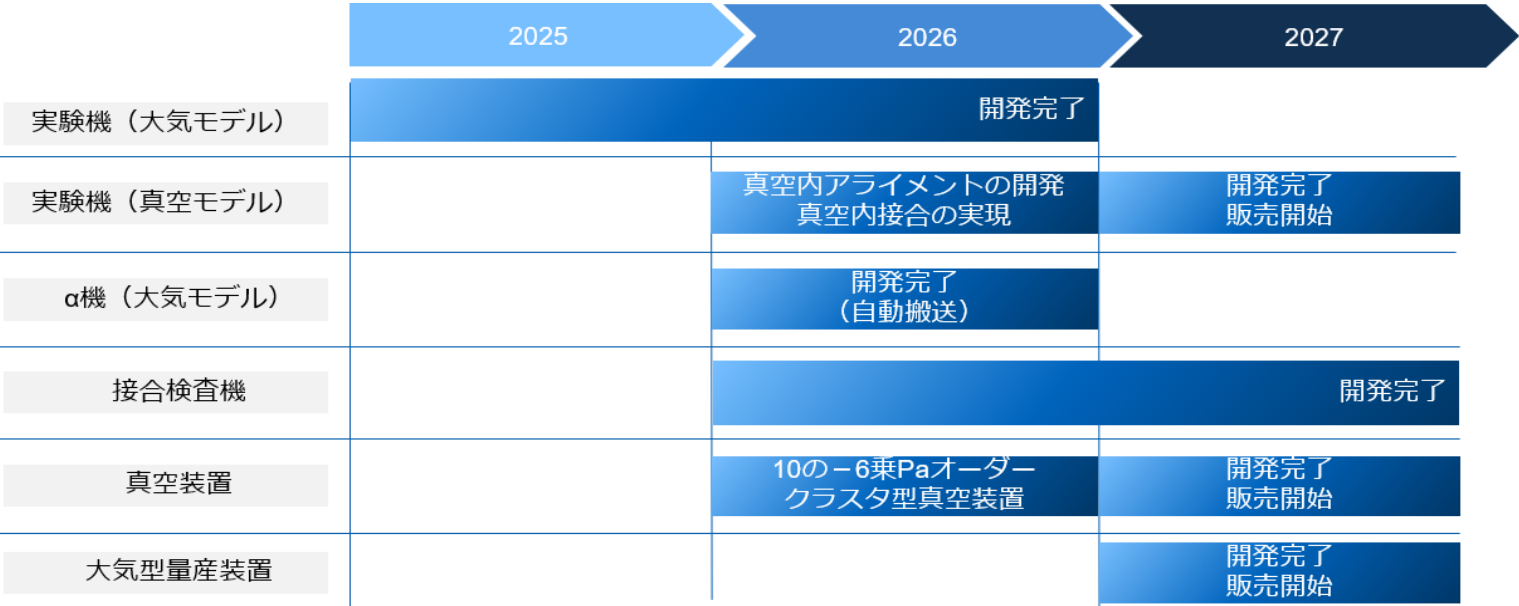
既存プロセス 課題

- ・ 不均一な接合力や非接合箇所が生じる懸念
- ・ 接合時にウェーハ全体が加熱されるため耐熱性MEMSしか対応できない
- ・ MEMSの加熱によりガスが発生し高真空が維持できない
- ・ 昇温、降温に時間がかかるためプロセスに時間がかかる
- ・ 熱膨張率が異なる材料では変形（反り）が生じる

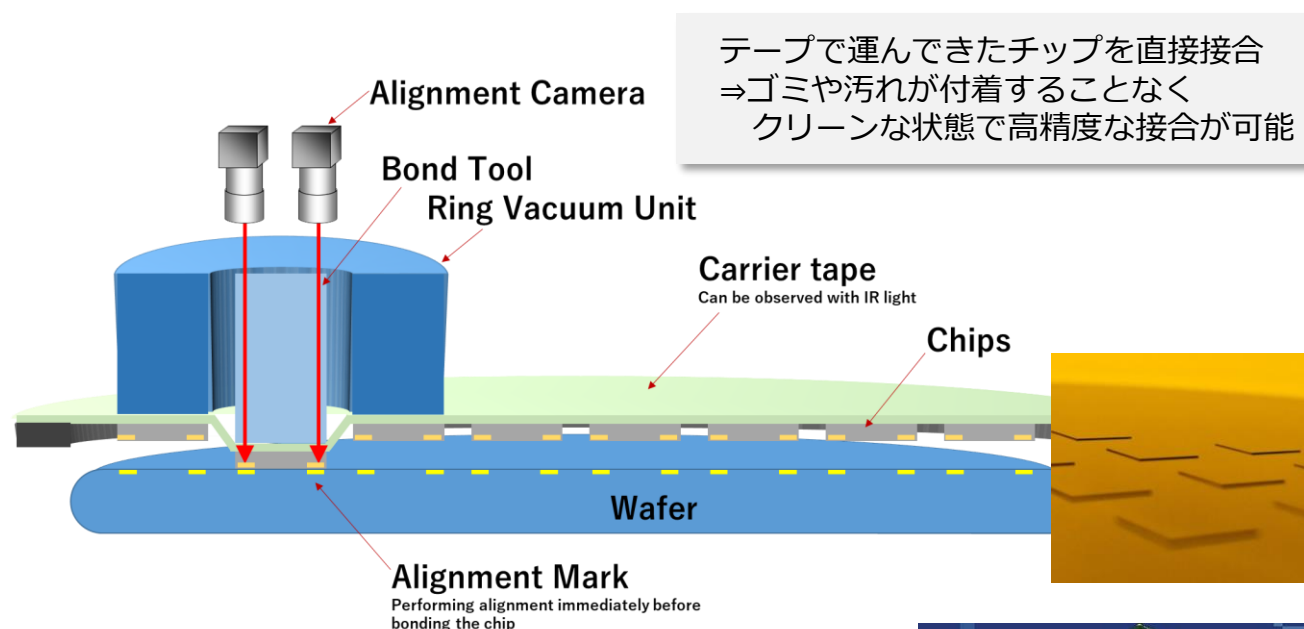
TAZMO LAB メリット

- ・ ウェーハ全面に均一な接合力
- ・ TTVが接合力の均一性に及ぼす影響なし
- ・ 接合線のみが加熱されるためデバイス部は低温で接合可能
- ・ MEMSキャビティ内のデガスが抑制でき高真空封止が可能
- ・ ウェーハ全域で低温接合となり熱膨張率が異なる材料の接合が可能
- ・ エネルギー効率がよく、低消費電力

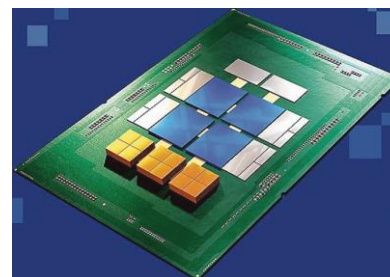
MEMS市場を初期参入領域とし、LAB技術を軸にパワー・先端パッケージへ事業領域を段階的に拡大。
今期より、装置の販売を開始し、売り上げにつなげる。



チップレット技術による新たなCoW接合装置を開発し、これらの課題に対して有効なソリューションを提供。今期、デモ機の製作を行い、具体的な受注に向けての取り組みを加速する。



	フリップチップボンダー	TAZMO DTB
チップのピックアップ	あり ⇒チップ汚染の可能性	なし ⇒高い清浄度を保持
チップ搬送	チップ毎 ⇒サイズに制約	テープで搬送 ⇒サイズフリー
アライメント	カメラを挿入 ⇒距離必要で高精度化難しい	テープを通して ⇒接合直近で高精度化容易
備考	従来技術 ⇒チップを個別に持ち替え搬送し接合する	新技術 ⇒チップを持ち替えることなく、キャリアテープから直接ウェーハに接合する



Interactive Presentations

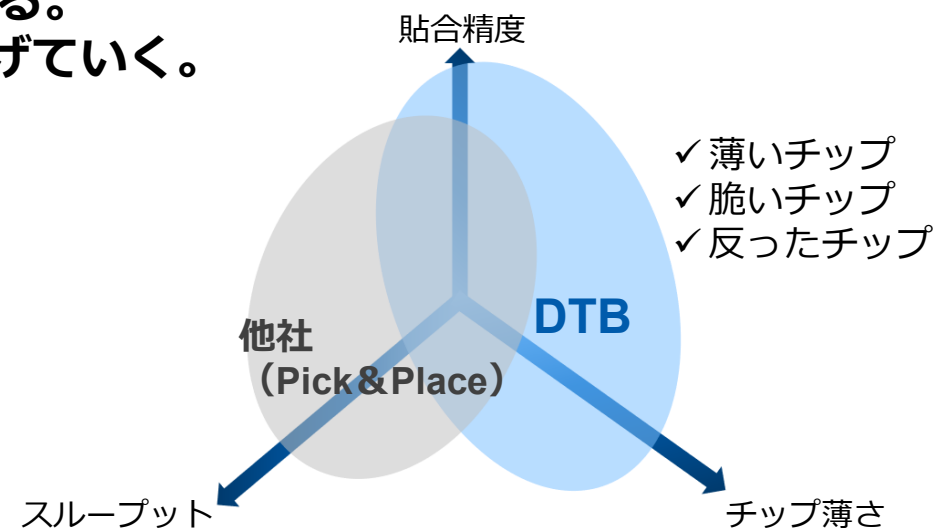
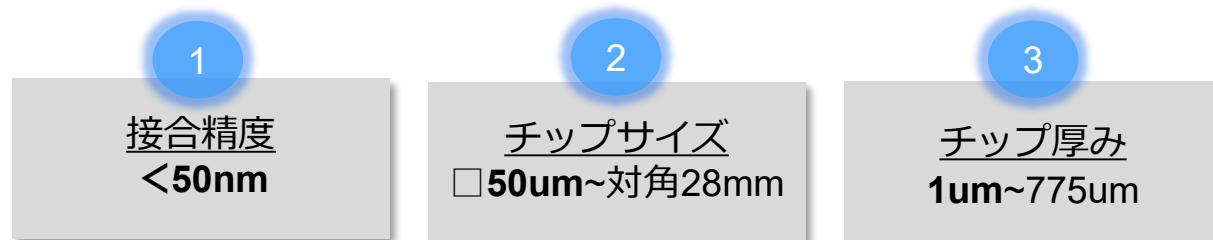
Direct Transfer Bonding of Ultra-Thin Warped Chips for Advanced Heterogeneous 3DIC Integration with Fine-Pitch Direct/Hybrid Bonding

AIやメタバースなどで求められる大規模処理では、従来ICの限界が顕在化しています。その課題を解決する有力な手法として注目されているチップレット技術の研究開発を、当社はチップレットコンソーシアムを通じて大学や企業と連携しながら推進しています。

国際的な学会で継続的に発表し、外部との技術交流を深めています。得られた意見をもとに、研究成果の磨き込みと実用化へつなげています。

2027年量産機リリースに向け現在多数ユーザーと検証を進めている。
その開発過程の中で、検証で得たデータや結果を基に受注につなげていく。

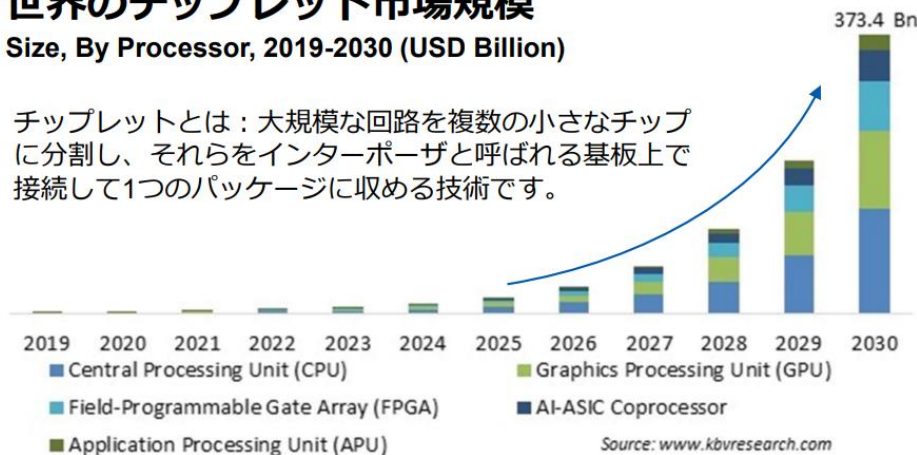
DTBの3つの圧倒的強み ※2027年ターゲット値



世界のチップレット市場規模

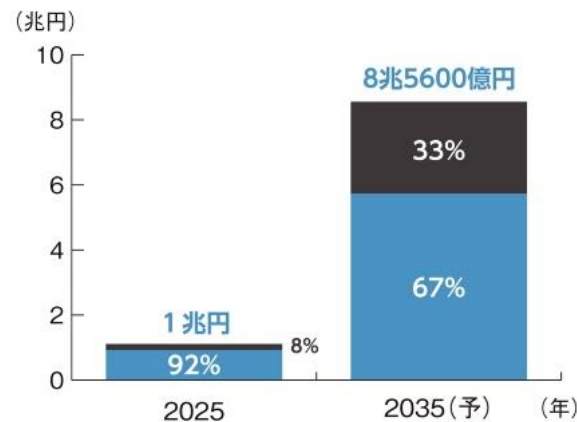
Size, By Processor, 2019-2030 (USD Billion)

チップレットとは：大規模な回路を複数の小さなチップに分割し、それらをインターポーザと呼ばれる基板上で接続して1つのパッケージに収める技術です。



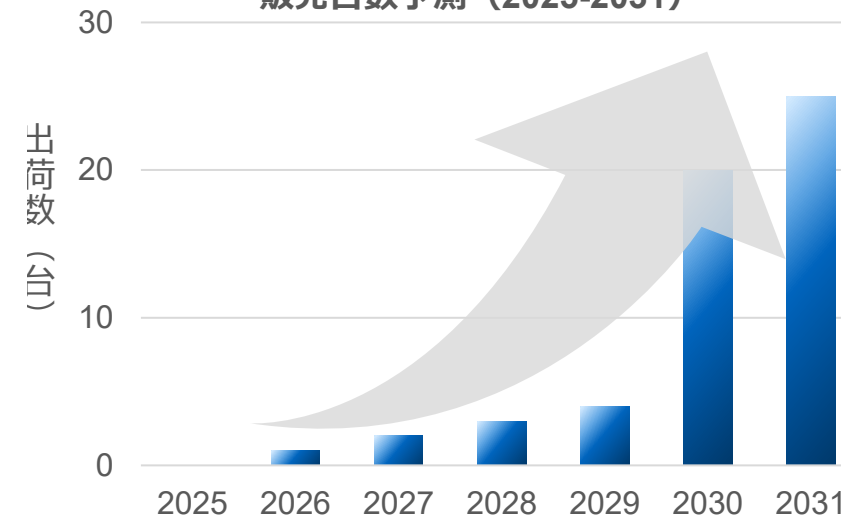
光集積回路 (PIC) の世界市場規模

Si 材料以外 (InP, LiNbO₃ など)
Si 材料

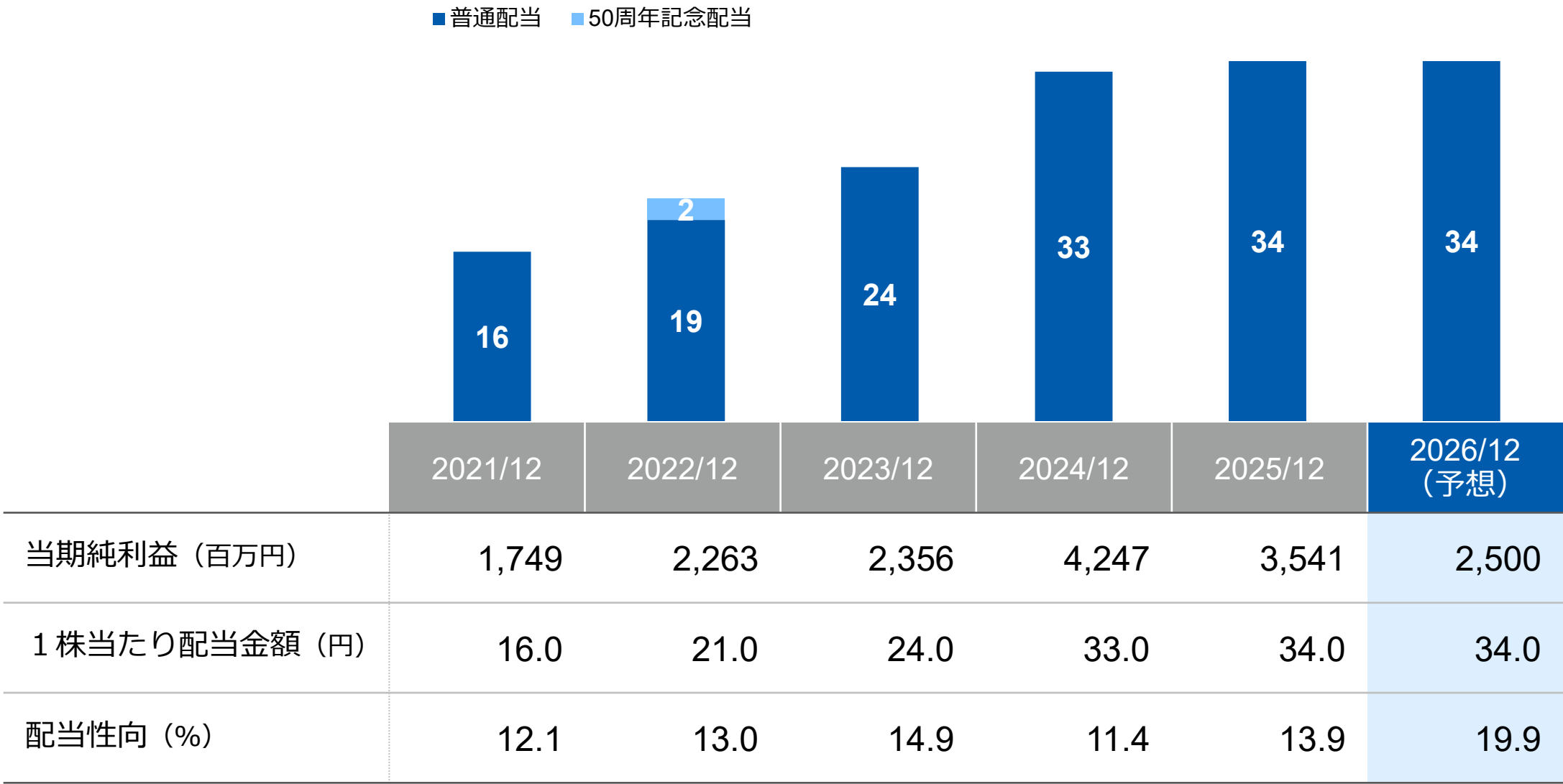


引用: <https://xtech.nikkei.com>

販売台数予測 (2025-2031)



- AI関連市場の拡大に伴い、先端パッケージ技術を使ったデバイスの生産は継続的に拡大している。OSATへの生産ラインの展開も含め、先端パッケージ向け装置の需要は今期も堅調に推移し、更に顧客対応を拡大していく。
- AIデバイスを中心にパッケージサイズの拡大と生産性向上から、パネル対応装置の引き合いが急増。これまでのFPD装置の知見も活かし、先端パッケージ向けPLP装置のプロセス・装置開発を進め、多様な引き合いに対応している。
- パワー半導体に関しては、中長期的にはEV市場や再生可能エネルギー、データセンターの増加に伴う需要増加を見込んだ設備投資意欲は高いと見ている。直近では中国市場での投資に取り組みつつ、今後の投資回復に備えていく。
- 搬送機器は、装置メーカーからの需要や中国市場での展開が伸び悩んでいたが、回復が見込まれる状況にある。フレームを含めた搬送機器の受注により注力することで販売単価と収益性の向上を狙う。
- 洗浄装置はウェーハメーカーの投資低迷の影響を受けているが、化合物半導体など新たなニーズの開拓を進めている。スラリー供給装置などの個別対応装置の受注販売に注力し進めている。
- 表面処理用機器事業では、自動車需要回復が遅れている状況下で、車載用プリント基板メーカーの投資の低迷が続いているが、今後の回復に備えるとともに、基板向け搬送機器の受注にも注力していく。



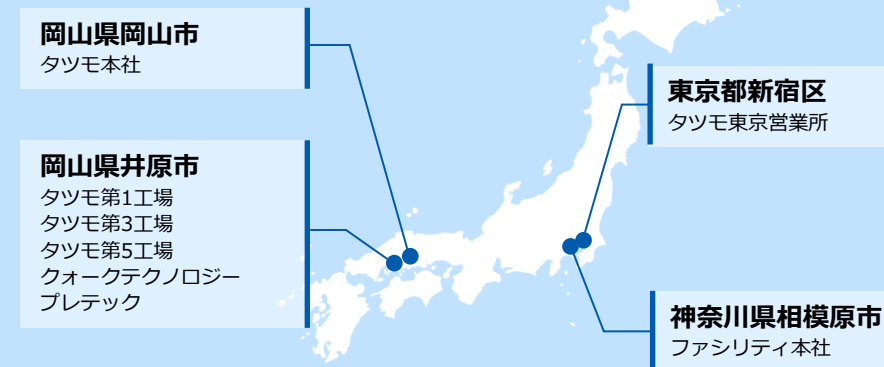


05

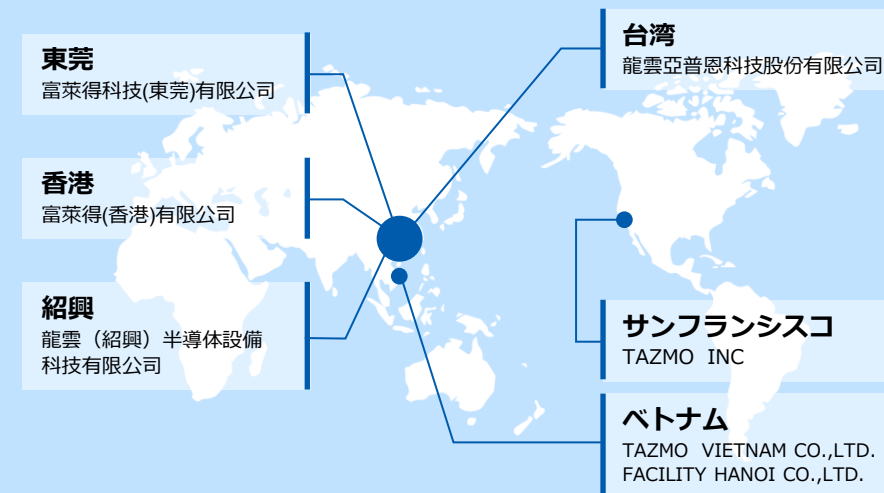
補足資料

商号	タツモ株式会社
設立	1972年（昭和47年）2月26日
本社所在地	岡山県岡山市北区芳賀5311
資本金	35億6,859万682円
発行済株式数	14,842,354株
株主数	9,433名（2025年12月31日現在）
従業員数	単体 449名／連結 1,150名（2025年12月31日現在）
事業内容	半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、 紫外線照射装置、めっき処理装置、 精密金型・樹脂成形品などの開発・製造・販売

主要な国内拠点・関連子会社



主要な海外拠点



- | | |
|---|--|
| <p>1972 ● - 電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立</p> <p>1980 ● - インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始
- 半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始</p> <p>1989 ● - 液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始</p> <p>1990 ● - 本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転
- スーパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始</p> <p>1994 ● - エンボスキャリアテープの製造・販売を開始</p> <p>1995 ● - インジェクション成形品の製造・販売を開始</p> <p>2001 ● - 半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、製造・販売を開始</p> <p>2004 ● - JASDAQ市場に株式を上場</p> <p>2008 ● - TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立</p> | <p>2009 ● - 第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
- 3M社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結</p> <p>2013 ● - アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化
- ロンアン省ロンハウ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築</p> <p>2017 ● - 株式会社ファシリティ、株式会社クォークテクノロジーを子会社化</p> <p>2018 ● - 東京証券取引所市場第一部へ市場変更</p> <p>2019 ● - 本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転</p> <p>2020 ● - アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併</p> <p>2022 ● - 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行
- 公募増資により、資本金34億9,540万円へ増資
- 中国における半導体関連機器の製造・販売拠点として龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司を浙江省紹興市に設立</p> |
|---|--|

半導体製造装置事業

貼合剥離装置

- 先端パッケージ向け装置（WLP ※1／PLP ※2）
- パワー半導体向け装置



高性能チップの製造に欠かせないウェーハの薄化を実現する仮接合・剥離装置の開発・設計・製造・販売を行っています。ウェーハにガラス支持体を貼り合わせることで、ウェーハの損傷を防ぎながら薄化が可能です。

厚膜塗布・現像装置

FPD製造装置の開発・製造で培った知見をもとに、均一な薬液の塗布の実現と、現像装置で露光された部分のみを洗い流すことで精密な回路作りを可能にしています。

※1 WLP：ウェーハレベルパッケージ
※2 PLP：パネルレベルパッケージ

搬送機器事業

- 半導体装置メーカー向け（ウェーハ、マスクなどに対応）



半導体製造装置内で使用される搬送ロボットや、ユニットをフレームに組み込んだEFEMなどの開発・設計・製造・販売を行っています。

洗浄装置事業

ウェーハメーカー向けの枚葉洗浄装置のほか、スラリー供給装置、廃液からリン酸を再生・再利用する装置の開発・設計・製造・販売を行っています。

表面処理用機器事業

半導体のパッケージや、自動車等の電子制御システムに組み込まれている、プリント回路基板に対するめっき処理装置の提供を行っています。

金型・樹脂成形事業

コネクタメーカー向けに精密金型や樹脂成形品を提供。

当社では、TCFD提言に基づく各種情報開示を行っています。

また、当社は国際的な環境情報開示プラットフォームであるCDPが実施する2025年気候変動分野で「B」スコアを獲得いたしました。

ガバナンス・リスク管理



- **サステナビリティ委員会を設置**
 - ・ 年2回（1月・7月）の開催
 - ・ 取締役会と連携しながら、推進施策の決定や全社の取り組みを監視
 - ・ 特に環境に対する取り組みは当委員会で方針を決定・各所に共有・報告を実施
- **報告を踏まえ、担当部署にリスク対策を含む事業戦略・中期計画の作成を指示**

戦略



- 将来の気候変動に対するリスクや機会を分析し、財務への影響について特定
- その対策として、下記を順次検討・実施
 - ・ **自家消費型太陽光発電設備の設置（2023年9月施工完了）**
 - ・ **全社照明設備のLED化の推進（2023年3月施工完了）**
 - ・ **再生可能エネルギー由来の電力などへ切り替え**
 - ・ **設備更新などによる電力効率化を順次推進**

指標と目標



- 事業活動を通じたカーボンニュートラルの実現を目指すため、自社のCO₂排出量を継続的に把握、削減目標達成のための施策を実行
- CO₂排出量については、現状は自社単体での開示を行い、順次グループ全体の排出量把握・削減への取り組み実行を予定

本資料の取扱上の注意

本資料は、2026年2月13日発表の決算短信に基づいて作成されております。

また、本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

本資料は投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、当社の発行する有価証券売買の勧誘を目的としたものではありません。

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社 経営企画室



086-239-5000



086-239-5100



keiki@tazmo.co.jp